산업통상부 보도자료

보도시점 2025. 12. 2.(화) 11:00 < 12.3.(수) 조간 > 배포 2025. 12. 2.(화)

반도체아카데미 교육 성료, 내년부터 국내 차량용반도체 활용한 신규교육 시동

- 올해 비수도권 교육센터 개소, 최첨단 칩 검증장비 도입 등 교육저변 확대 중점
- 내년부터 AI반도체, 국산 차량용반도체 등 신규 교육과정 개설 계획

산업통상부(장관 김정관, 이하 산업부)가 지원하고 한국반도체산업협회가 운영하는 한국반도체아카데미(이하 아카데미)가 올해 주요 교육 프로그램을 성공적으로 마무리하였다. 아카데미는 내년부터 AI반도체, 국산 차량용 반도체 등 AI·미래차와 반도체를 융합한 신규교육을 제공할 계획이다.

아카데미는 2023년 설립 이후 반도체 분야 취업 준비생과 기업 재직자를 대상으로 반도체 설계, 소부장, 후공정 등 산업 수요 기반의 이론· 실습 교육을 제공해왔다. 올해 6월에는 수도권(용인, 판교)에 집중돼 있던 교육 인프라를 비수도권으로 확충하기 위해 아산(호서대), 창원(경남TP 등) 교육센터를 추가로 개소하고 전력반도체 및 패키징·테스트 전문교육을 시작했다. 또한, 8월에는 글로벌 EDA* 기업으로부터 최첨단 칩 검증 장비를 지원받아 교육인프라 수준을 한층 강화했다. 이러한 노력에 힘입어 아카데미는 올해 1,169명에 달하는 취업준비생과 재직자에게 양질의 교육을 제공하였다.

* EDA(Electronic Design Automation): 컴퓨터 SW를 통해 칩 설계·검증 과정을 全 자동화

내년부터는 AI·미래차 등 첨단산업과의 융합을 중심으로 교육 분야를 확대한다. 3D AI반도체 구현을 위한 가상환경 기반의 공정설계 교육과 반도체 장비 분석에 AI를 활용하는 AX 교육을 신설한다. 또한, 국내 차량용 반도체 설계 기업과 협력하여 미래차에 요구되는 고성능 차량용 칩 테스트 교육도 운영한다. 특히, 누구나 자유롭게 수정·활용 가능한 최신 무상 교육 소프트웨어를 도입함으로써 국산 차량용 칩을 실습에 활용하기 어려웠던 비용 장벽을 해소할 것으로 기대된다.

산업부 관계자는 “아카데미는 산·학·연의 지속적이고 긴밀한 협력을 바탕으로 단기간에 국내 대표 반도체 교육기관으로 성장할 수 있었다”며, “앞으로도 더욱 발전된 아카데미를 통해 반도체 우수인재 양성에 대한 지원을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	주무관	배재현 (044-203-4254)

대한민국 정책브리핑

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 **반도체아카데미 개요 및 성과**

□ 사업 개요

○ **(내용)** 반도체 기업의 만성적 인력부족 해소를 위해 **산업계 수요 기반** 교육과정 운영을 통한 **현장 맞춤형 인력양성 지원**

○ **(추진경과*)** 출범('22.12) → 교육 개시('23.4) → 비수도권 확장('25.6)

* 용인('23, 소부장), 판교('24, 설계) → 아산·창원('25, 패키징·테스트)

○ **(교육대상)** 취업준비생(대학(원)생 등), **재직자**(신입, 경력) 등

□ 주요 성과('25)

○ **(교육운영)** 전체 36개 교육과정 중 **주요 교육**(기초·심화) **32개***를 운영하고 재직자와 취업준비생 **1,169명 교육 완료**

* 현재 진행 중인 **단기 4개 과정**은 **12월 중 수료 예정**

구분(~'25.11末)		수도권	비수도권	소계	합계
교육인원	취업준비생	311	165	476	1,169
	재직자	693	-	693	
수료인원	취업준비생	272	134	406	1,087
	재직자	681	-	681	

○ **(산학협력)** 참여기업-교육생 간 **채용연계 지원** 및 대학 **학점인정 교육** 위한 **신규 MOU 4건* 체결**(전체 18개 대학)

* 신규 MOU 체결 대학('25): 서울과학기술대, 단국대, 한양사이버대, 한국공학대

○ **(비수도권 확대)** 호서대(아산)**패키징 및 테스트,** 경남TP등(창원)**전력반도체 신뢰성 평가** 중심의 취업준비생 대상 **6개 과정** 운영('25.6~)

○ **(인프라 구축)** 글로벌 반도체 설계 EDA 기업의 **최첨단 칩 검증 장비**(30억원 규모) 1대를 **무상 지원**받아 **실습 교육에 활용** 운영('25.8~)

